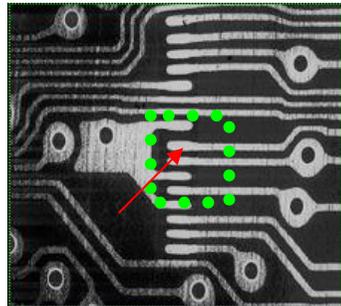
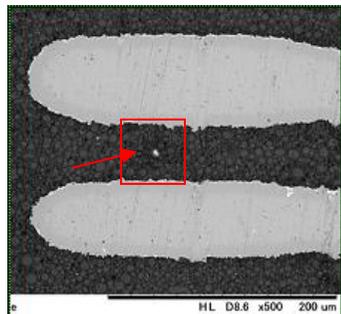


平面研磨によるPKG内の故障解析

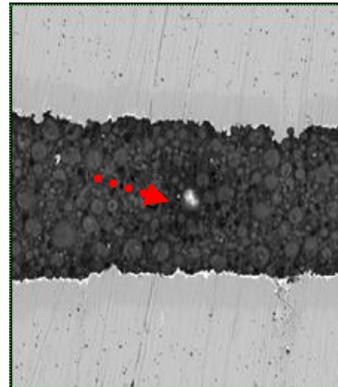
<電気的特性で故障箇所を絞込む>



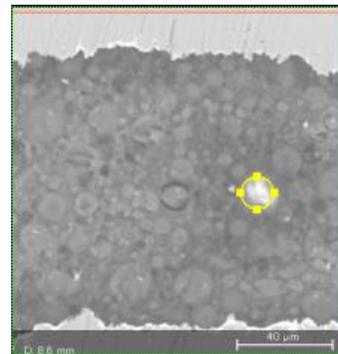
- PKG表面からL/F手前まで慎重に研磨する。
正しい観察が重要で、研磨する試料の構造を把握できる資料（X線画像）等の準備が大切です。
- 研磨目的箇所到達するまで「研磨量調整ユニット」を活用します。
機械的研磨は「使用化学物質」が少ないので、正しい異物の分析が可能となります。



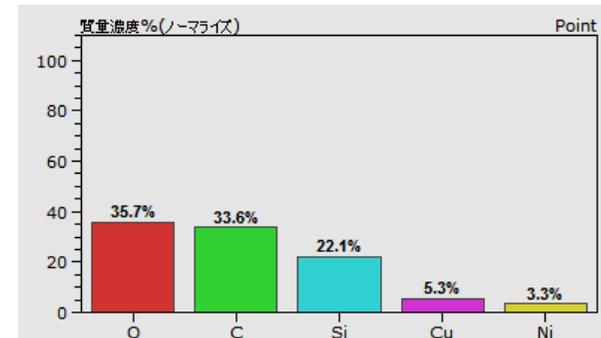
SEM観察結果-1



PKGの平面研磨で異物を露出
→SEM観察



SEM観察結果-2
→異物の分析を行う



異物は、分析の結果Cuと判明。
X線では検出しづらいものです

- 研磨机が：ガラス試料机が
- 研磨ポイント：電気的特性結果で絞りこんだ部位を研磨／観察を繰り返しながら研磨加工する。研磨量調整ユニット機構を使用し観察点を絞り込む。